



贵金属电镀药剂:

产品名称	用途	特点
H-8 (硫酸铈镀液)	接点部材/半导体 (MEMS)	保持压缩应力, 实现数十 μm 以上的超厚层
F-9 (硫酸铈镀液)	装饰/接点部材/半导体 (MEMS)	白色光泽/高硬度/耐摩耗性, 电沉积均匀良好
F-20 (硫酸铈镀液)	装饰/接点部材/半导体 (MEMS)	可实现低电阻 (比电阻不超过 $10 \mu\Omega \cdot \text{cm}$) / $10 \mu\text{m}$ 厚层
AQ-Ru (黑色硫酸钌镀液)	装饰	黑色光泽
硫酸钌镀液	装饰/接点部材	白色光泽/高硬度/耐摩耗性良好
Rotenium (Rh-Ru合金镀液)	装饰/接点部材	白色光泽/高耐腐蚀性并可进行Reel to Reel的处理
E-Au-7 (Au-Co镀液)	电子元件 (端子) / 接点部材	光泽皮膜/耐腐蚀性和耐摩耗性良好/Co含有率 (0.3~0.5%)
E-Au-9 (Au-Co镀液)	电子元件 (端子) / 接点部材	可提供高速镀/光泽皮膜/耐腐蚀性和耐摩耗性良好/Co含有率 (0.2~0.5%)
E-Au-PG (纯Au镀液)	半导体, PWB (键合线)	半光泽至无光泽皮膜/皮膜中金的品位不低于 99.9%
F-Au-3 (冲击镀纯Au镀液)	装饰/电子元件	光泽皮膜, 耐腐蚀性良好
MS-5 (电镀银液)	IC引线框架/半导体分立器件用引线框架/连接器	适用于大范围的电流密度 ($10 \sim 100 \text{A}/\text{dm}^2$)